(51) 国際特許分類7:

G03F 7/039, 7/004, H01L 21/027

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015504

(22) 国際出願日:

2004年10月20日(20.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-363521

2003年10月23日(23.10.2003) л 特願2003-410489 2003年12月9日(09.12.2003) ЛР 特願2004-057448 2004年3月2日(02.03.2004) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東 京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸 子 1 5 0 番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 羽田 英夫 (HADA, Hideo) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸 子150番地東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 竹下 優 (TAKESHITA, Masaru) [JP/JP]; 〒2110012 神 奈川県川崎市中原区中丸子150番地東京応化工業 株式会社内 Kanagawa (JP). 林 亮太郎 (HAYASHI, Ryotaro)[JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 松丸 省吾 (MATSUMARU, Syogo) [JP/JP]; 〒2110012

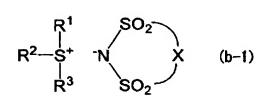
神奈川県川崎市中原区中丸子 150番地 東京応化 工業株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 拓 (HIRAYAMA, Taku) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸 子 1 5 0番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 清水 宏明 (SHIMIZU, Hiroaki) [JP/JP]; 〒2110012 神奈 川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業 株式会社内 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 棚井 澄雄 , 外(TANAI, Sumio et al.); 〒 1048453 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

## (54) Title: RESIST COMPOSITION AND METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN

## (54) 発明の名称: レジスト組成物およびレジストパターン形成方法



$$R^{1}$$
  $O_{2}S-Y$ 
 $R^{2}-S^{+}$   $N$  (b-2)
 $R^{3}$   $O_{2}S-Z$ 

(57) Abstract: Disclosed is a resist composition which enables to achieve fine resolution, improved line edge roughness and improved depth of focus. This resist composition contains (A) a resin component whose alkali solubility is changed by the action of an acid, and (B) an acid generator component which generates an acid through exposure. The component (A) is a resin with a mass average molecular weight of not more than 8,000 which contains a constitutional unit (a) derived from a (meth)acrylate, and the component (B) contains at least one kind of sulfonium compound represented by the following general formula (b-1) or (b-2). (b-1) (b-2)

微細な解像性、改善されたラインエッジラ フネス及び焦点深度幅を与えるレジスト組成物が提供さ れる。この組成物は、(A)酸の作用によりアルカリ可 溶性が変化する樹脂成分、および(B)露光により酸を 発生する酸発生剤成分を含有するレジスト組成物であっ て、前記(A)成分が、(メタ)アクリル酸エステルか

ら誘導される構成単位(a)を含む質量平均分子量が8000以下の樹脂であり、前配(B)成分が、下配一般式 (b-1) または (b-2) で表される少なくとも 1種のスルホニウム化合物を含有する。 【化1】

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。